

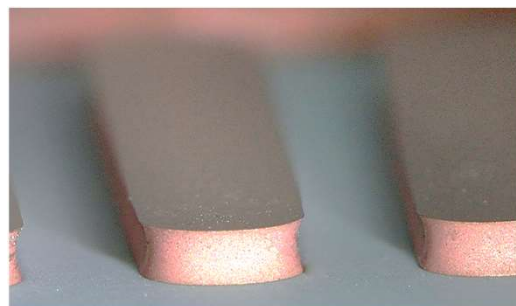
パワーデバイス用基板

PCB for Power semiconductor devices



パワーデバイスやコイル等の大電流を流す必要のある基板に使用可能な極厚回路形成基板です。

当社の特許を取得した独自の設備を使用した精密なエッチングと、独自開発したエッチング工法により、一般的なエッチング法によるパターンピッチより大幅に狭ピッチ化し、大電流基板の小型化・高密度化を実現しました。金属基板と高放熱・高耐熱素材を組み合わせ温度上昇抑制が可能です。



同一銅厚でのエッチングミニマム値比較

銅厚 (mm)	一般的なエッチングによる パターン形成				当社通常エッチング工法による パターン形成				当社独自特殊エッチング 工法によるパターン形成 NEW			
	ライン (mm)		ギャップ (mm)	ピッチ: P (mm)	ライン (mm)		ギャップ (mm)	ピッチ: P (mm)	ライン (mm)		ギャップ (mm)	ピッチ: P (mm)
	Top : T	Bottom : B	Bottom : b		Top : T	Bottom : B	Bottom : b		Top : T	Bottom : B	Bottom : b	
0.5	0.70	1.10	0.80	1.90	0.50	0.75	0.70	1.45	0.50	0.50	0.50	1.00
0.8	0.70	1.30	1.20	2.50	0.60	1.00	0.80	1.80	0.60	0.60	0.60	1.20
1.0	—	—	—	—	0.70	1.20	0.90	2.10	0.70	0.70	0.70	1.40

※一般データは参考値です。 ※仕様により最適な提案をさせていただきますので詳しくはお問合せ下さい。

用途例

パワーデバイス、大電流コイル基板、LED照明、パワーエレクトロニクス機器、ハイブリッドカー・電気自動車のハイパワーモーター制御ユニットなど



日本ミクロン株式会社

www.nihon-micron.co.jp

☎ 0266-23-8373

(土日・弊社指定休日を除く8:30~17:20)

✉ nmadpt@nihon-micron.co.jp

FAX 0266-23-1223